



JASM

2

## 公司概況

---

民國一百一十二年，台積公司晶圓出貨量達  
1,200 萬片十二吋晶圓約當量

## 2.1 公司簡介

民國七十六年，台積公司成立於台灣新竹科學園區，並開創了專業積體電路製造服務商業模式。台積公司專注於生產由客戶所設計的晶片，本身並不設計、生產或銷售自有品牌產品，確保絕不與客戶競爭。基於這個創始的原則，台積公司成功的關鍵就在於協助客戶獲得成功。台積公司的專業積體電路製造服務商業模式造就了全球無晶圓廠IC設計產業的崛起。自創立以來，台積公司一直是世界領先的專業積體電路製造服務公司，單單在民國一百一十二年，台積公司就以288種製程技術，為528個客戶生產1萬1,895種不同產品。

台積公司的眾多客戶遍布全球，為客戶生產的晶片廣泛地被運用在各種終端市場，例如高效能運算、智慧型手機、物聯網、車用電子與消費性電子產品等。如此多樣化的晶片生產有助於緩和需求的波動性，使公司得以維持高產能利用率及獲利率，以及穩健的投資報酬以因應未來的投資。

民國一百一十二年，台積公司及其子公司所擁有及管理的年產能超過1,600萬片十二吋晶圓約當量。台積公司在台灣設有四座十二吋超大晶圓廠（GIGAFAB® Facilities）、四座八吋晶圓廠和一座六吋晶圓廠，並擁有一家百分之百持有之海外子公司—台積電（南京）有限公司之十二吋晶圓廠，以及二家百分之百持有之海外子公司—TSMC Washington（更名前為WaferTech）美國子公司、台積電（中國）有限公司之八吋晶圓廠的產能支援。

民國一百一十二年八月，台積公司宣布將共同投資位於德國德勒斯登的歐洲半導體製造公司（European Semiconductor Manufacturing Company (ESMC) GmbH, ESMC），興建一座特殊製程晶圓廠，以支援汽車和工業市場未來的產能需求。ESMC由台積公司持有70%股權，博世、英飛凌和恩智浦則各持有10%股權，總計投資金額預估超過100億歐元。此計劃興建的晶圓廠預計採用台積公司28/22奈米平面互補金屬氧化物半導體（Complementary Metal Oxide Semiconductor, CMOS），以及16/12奈米鰭式場效電晶體（FinFET）製程技術，完工後月產能約40,000片300mm（十二吋）晶圓。ESMC目標

於民國一百一十三年下半年開始興建晶圓廠，並於民國一百一十六年底開始生產。

台積公司持續執行其於美國亞利桑納州設立晶圓廠的計劃。美國廠第一期工程預計於民國一百一十四年上半年開始生產，第二期建廠工程正在進行中。同時，台積公司於日本熊本縣設立晶圓廠，並預計於民國一百一十三年底開始生產。

台積公司在北美、歐洲、日本、中國大陸，以及南韓等地均設有子公司或辦事處，提供全球客戶即時的業務與技術服務。至民國一百一十二年年底，台積公司及其子公司員工總數超過7萬6,000人。

台積公司股票在台灣證券交易所上市，股票代碼為2330，另有美國存託憑證在美國紐約證券交易所掛牌交易，股票代號為TSM。

## 2.2 市場概況

### 2.2.1 台積公司卓越表現

民國一百一十二年，台積公司保持其在全球半導體產業之積體電路製造服務領域的領導地位，其產出占全球半導體（不含記憶體）市場產值的28%，主要因半導體產業庫存調整的關係，而較民國一百一十一年度的30%減少。

擁有最先進的製程技術是台積公司在專業積體電路製造服務領域取得強大市場地位的重要關鍵。民國一百一十二年，有58%的晶圓營收來自先進製程技術（7奈米及以下更先進製程），高於民國一百一十一年度的53%。

台積公司提供客戶完備的製程技術，並且持續投資先進製程技術、特殊製程技術，以及先進封裝與矽堆疊技術，以提供客戶更多附加價值。

除了擁有在先進製程技術和特殊製程技術的領導地位，台積公司亦提供TSMC 3DFabric®—完備的三維堆疊（3D Silicon Stacking）和先進封裝系列技術，與其製程技術發揮相輔相成的效益。TSMC 3DFabric®系列技術為客戶提供更靈活的晶片設計彈性來釋放創新，是台積公司有別於競爭對手的另一差異化競爭優勢。

### 2.2.2 市場分析

台積公司估計民國一百一十二年全球半導體（不含記憶體）市場產值將達到美金4,810億元，較民國一百一十一年衰退2%。其中，從事半導體製造的積體電路製造服務業產值衰退至美金1,140億元，較民國一百一十一年衰退13%。

### 2.2.3 產業未來展望、機會與挑戰

#### 積體電路製造服務市場的需求與供給

民國一百一十二年，台積公司在積體電路製造服務領域的衰退主要受影響於疲弱的電子產品終端需求及供應鏈庫存調整。雖然產業大趨勢諸如5G、AI以及加速數位化轉型等維持不變，總體經濟的不確定性同時抑制消費與企業支出兩者，導致許多電子產品諸如智慧型手機與個人電腦需求下滑。除此之外，民國一百一十二年電子業供應鏈也正經歷嚴峻的庫存調整以消化過去兩年因供給的不確定性而累積之超額庫存，影響積體電路製造服務業與台積公司的成長。

展望民國一百一十三年，總體經濟與地緣政治的不確定性仍高。然而，台積公司預計許多電子產品終端需求，諸如智慧型手機與個人電腦，在連續兩年衰退後受壓抑的需求支撐下逐漸恢復為溫和成長。此外，AI相關的加速導入也將引燃半導體需求。另外，台積公司也估計系統公司與積體電路公司的整體超額庫存將大部分在民國一百一十三年上半年被消化且回至健康水位，為民國一百一十三年之成長設立堅固基礎。長期而言，因上述大趨勢與電子產品採用半導體的含量提升，台積公司預計自民國一百一十二年及民國一百一十七年，全球半導體（不含記憶體）市場成長為高個位數百分比年複合率。在此之上，台積公司預期積體電路製造服務領域的成長可望較全球半導體（不含記憶體）市場之年複合成長率更為強勁，源於無晶圓廠設計公司持續擴大市占率，整合元件製造商增加委外製造，以及系統公司增加採用自有特殊應用元件（Application Specific Integrated Circuits, ASIC）等因素。

作為半導體產業鏈的上游供應商，積體電路製造服務領域與主要產品平台的市場健康性息息相關，包含高效能

運算、智慧型手機、物聯網、車用電子與消費性電子產品（DCE）。

#### ● 高效能運算

高效能運算平台包括個人電腦、平板電腦、遊戲機、伺服器、基地台等。民國一百一十二年，主要高效能運算產品單位出貨量衰退了14%，主要歸咎於居高不下的通貨膨脹、整體經濟不確定性，以及庫存持續修正導致消費者端之需求疲軟。在此同時，具備人工智慧（AI）加速器的伺服器與數據中心之需求相對健康，以滿足在人工智慧應用上日益增加的類型與需求，特別是生成式人工智慧，以及持續的5G基地台部署。

邁入民國一百一十三年，儘管整體經濟不確定性仍舊存在，台積公司預估正常化的庫存，在連續兩年衰退後受壓抑的需求支撐，以及持續的人工智慧軍備競賽，將驅使高效能運算產品單位出貨量呈現低個位數百分比成長。長期來說，隨著產業開始邁入5G時代，一個更智慧化且更加互聯的世界，將會需求大量運算能力及低耗能運算。這兩項都需要更高性能及更佳功耗效率的中央處理器（Central Processing Units, Cpus）、繪圖處理器（Graphics Processor Units, GPUs）、網路處理器（Network Processing Units, NPU）、人工智慧加速器與相關的特殊應用積體電路，並將驅動整體高效能運算平台朝向更豐富的半導體含量、更先進製程技術與3D封裝邁進。基於台積公司在這些領域的技術領先地位，這些趨勢對台積公司是有利的。

#### ● 智慧型手機

由於受到較高通膨、全球經濟走緩和持續的俄烏戰爭和的影響，智慧型手機的單位出貨量在民國一百一十二年衰退6%，反映出5G商用化的趨緩和造成4G市場的延長換機週期，經過漫長的智慧型手機供應鏈庫存修正後、週期性需求復甦和新興國家帶動智慧型手機成長，台積公司預估民國一百一十三年智慧型手機市場將呈現低個位數百分比成長。長期來看，由於智慧型手機持續演進至5G，加上擁有更高性能、更長電池使用時間、生理感應器及更多邊緣人工智慧應用，將持續推動智慧型手機銷售。

高性能與高能源效率的積體電路技術是手機製造商的基本要求，而高度整合的晶片和先進的3D封裝設計是最佳化成本、能耗及規格（晶片面積與高度）的首選解決方案。在邊緣人工智慧應用、各種複雜軟體運算與高解析度相片和視訊處理的高效能需求刺激之下，先進製程技術將持續推進。台積公司在製造高度整合晶片和先進3D封裝設計是公認的製程技術領導者，因此在服務智慧型手機市場處於非常有利的位。

#### ●物聯網

物聯網平台包含各式各樣的智慧聯網裝置，如穿戴、健康偵測、家庭與工業自動化裝置等。疫情後，數位轉型已重啟動能並重新驅使物聯網成長，然受到全球高通膨與經濟增長放緩影響消費者與企業支出，民國一百一十二年物聯網裝置單位出貨量僅成長3%，並以智慧健康與智慧零售裝置為主要成長動能。

隨著物聯網裝置加入更多人工智慧功能，預期物聯網產業仍維持長期成長趨勢。預期民國一百一十三年上半年預計仍將受到經濟影響，下半年將恢復成長動能，整體來看，台積公司預測民國一百一十三年物聯網單位出貨量將呈現高個位數百分比成長。此外，由於物聯網裝置將採用更多人工智慧功能，物聯網裝置將需要更高性能並更省電的各種晶片。台積公司提供多種符合物聯網產業需求之製程，包含最先進製程技術，超低功耗（Ultra-Low Power, ULP）與各種特殊製程技術，持續協助客戶提供差異化且具競爭力的創新產品，並滿足永續發展需求。

#### ●車用電子

全球汽車市場繼續從過去幾年的供應限制中復甦。隨著供應鏈正常化，受壓抑的消費者需求得到滿足和汽車製造商庫存補貨得到支持，民國一百一十二年全球汽車產量增加9%。然而，高通膨和宏觀經濟不確定性等持續的不利因素預計將導致民國一百一十三年全球汽車產量成長率呈現低個位數衰退。

整體汽車產業正朝向更環保、更安全與更智慧化的大趨勢邁進，這將加速電動汽車（Electric Vehicle, EV）、先

進駕駛輔助系統（Advanced Driver-Assistance Systems, ADAS）與智慧座艙資訊娛樂系統，以及新的電氣／電子（Electrical/Electronic, E/E）架構的採用。所有這些都將導致對應用處理器（Application Processor, AP）／微控制器（Microcontroller, MCU）／特殊應用元件（ASIC）、車內網路、感測器和電源管理IC的需求增加，從而使每輛汽車的半導體含量不斷提升。台積公司有能力的支持汽車產業轉型的大趨勢，提供先進的製程技術和製造解決方案，使客戶能夠在汽車市場上提供具有競爭力的產品。此外，台積公司還提供一系列汽車級製造流程，包括AEC-Q100和ISO 26262認證，以確保汽車應用的最高品質水準和可靠性。

#### ●消費性電子產品

民國一百一十二年全球數位消費性電子市場下滑3%，因為許多消費者在疫情期間已經滿足了對電視、機上盒（Set-top Box, STB）和其他消費產品的需求。抗衡增長的更換週期，以及高通膨和升息導致消費者預算被壓縮，美國電視市場因通路庫存不足後補貨而出貨量上升，但被中國因房地產市場疲軟、結婚率低以及中美脫鉤導致經濟和消費疲軟所導致之需求疲軟所抵消。

預期民國一百一十三年，歐洲及新興地區市場將逐步復甦。因此，台積公司預測出貨量將呈現低個位數的年成長率。數位消費性電子市場的潛在成長動力來自大螢幕、120Hz/165Hz高幀率遊戲電視、語音AI控制、WiFi 6連接等有吸引力的功能。無論經濟何時恢復，台積公司的先進技術將持續協助客戶在DCE市場創造和提供差異化的創新產品。

#### 產業供應鏈

電子產品的供應鏈冗長而複雜，且各個環節環環相扣。身處產業鏈的上游，半導體元件供應商必須提供充足且彈性的供貨以因應市場需求的激烈變化，而積體電路製造服務產業更是確保產業鏈健康、穩健的重要角色。台積公司身為積體電路製造服務領域的領導者之一，將持續提供下游產業鏈創新所需的最先進製程技術及具規模的產能。

## 2.2.4 台積公司之市場定位、差異化與策略

### 台積公司的市場定位

台積公司在先進製程技術、特殊製程技術，以及先進封裝技術的發展上，是全球積體電路製造服務領域的領導公司之一。民國一百一十二年，台積公司產出占全球半導體（不含記憶體）市場產值的28%，主要因半導體產業庫存調整的關係，而較民國一百一十一年度的30%減少。台積公司營業收入淨額以地區劃分（主要依據客戶營運總部所在地），北美市場占68%、中國大陸市場占12%、亞太市場（不含日本與中國大陸）占8%、歐洲、中東及非洲市場占6%、日本市場占6%。依據產品平台來區分，高效能運算占43%、智慧型手機占38%、物聯網占8%、車用電子占6%。此外，消費性電子產品占2%，其他產品則為剩餘的3%。

### 台積公司的差異化優勢

台積公司的領導地位奠基於三大明確的競爭優勢及長期以來承襲的業務策略，公司憑藉「先進技術、卓越製造、客戶信任」在競爭中脫穎而出。

身為技術領導者之一，台積公司一直以來均是首家推出最新世代技術的專業積體電路製造服務公司；同時，台積公司也在較成熟的製程技術取得領先地位，此係因為台積公司將先進技術開發的經驗導入特殊製程技術所致。除了製程技術之外，台積公司優異的前段及後段製程整合能力，提供功耗、效能及晶片尺寸最佳化的競爭優勢，協助客戶更快速進入生產。

台積公司領先業界的積體電路製造能力已經獲得高度肯定，並藉由「開放創新平台」（Open Innovation Platform® Initiative）及台積大聯盟（TSMC Grand Alliance）更進一步強化台積公司的領導地位。台積公司的「開放創新平台」加速半導體設計產業與台積公司設計生態系統合作夥伴的創新，也加速台積公司自有矽智財開發、設計技術協同優化能力、製程技術與後段服務的創新。「開放創新平台」是一個完整的設計生態系統，藉由台積公司所開發、支援的協同合作平台，加速供應鏈各方面的創新，因而產生並共享新增的營收與獲利；而台積大

聯盟則是由台積公司客戶、電子設計自動化（Electronic Design Automation, EDA）夥伴、矽智財（IP）夥伴，以及新成立的3DFabric®聯盟夥伴、主要設備及原物料供應商及台積公司所共同組成，是半導體產業中最強而有力的創新動能之一。透過此一嶄新、更高層次的協同合作，希望能夠協助客戶、聯盟成員及台積公司都能強化競爭優勢並贏得商機。

台積公司自民國七十六年成立以來，始終秉持「絕對不與客戶競爭」的承諾，而這正是客戶信任台積公司的基礎。秉持此一承諾，台積公司從未設計、生產或銷售任何自有品牌的晶片產品，而是投注公司所有努力與資源成為客戶所信賴的專業積體電路製造服務公司。

### 台積公司策略

台積公司深信，差異化的競爭優勢將使台積公司更能把握未來積體電路製造服務領域的成長機會。針對智慧型手機、高效能運算、物聯網、車用電子，以及消費性電子產品這五個主要市場，及因應客戶需求從以製程技術為中心轉變為以產品應用為中心，台積公司已經分別建構五個對應的技術平台，提供客戶完備且具競爭優勢的邏輯製程技術、特殊製程技術、矽智財，以及封裝測試技術，協助客戶縮短晶片設計時程及加速產品上市速度。這五個技術平台分別為：

**高效能運算：**在巨量數據運算和人工智慧應用創新的驅動下，高效能運算已成為台積公司業務增長的主要動力之一。台積公司為無晶圓廠設計公司及系統公司客戶提供領先的邏輯製程技術，例如3奈米鰭式場效電晶體（3nm FinFET, N3）、4奈米鰭式場效電晶體（4nm FinFET, N4）、5奈米鰭式場效電晶體（5nm FinFET, N5）、6奈米鰭式場效電晶體（6nm FinFET, N6）、7奈米鰭式場效電晶體（7nm FinFET, N7）、12奈米／16奈米鰭式場效電晶體（12/16nm FinFET, N12/N16）等，以及包括高速互連技術等完備的矽智財，以滿足客戶產品在任何地點、時間傳輸和處理大量資料的需求。尤其，台積公司推出了為高效能運算產品所量身打造的製程技術-N4X和N3X，分別在台積公司5奈米和3奈米系列製程技術中，展現極致效能與最高運作時脈。基於先進製程技術，多種高

效能運算產品已被導入市場，例如人工智慧加速器（人工智慧繪圖處理器和人工智慧特殊應用元件）、個人電腦中央處理器、消費性繪圖處理器、可程式邏輯閘陣列（Field programmable gate array, FPGA）、伺服器處理器、高速網路晶片等。這些產品可以應用於當前及未來的5G/6G通訊基礎設備、人工智慧、雲端（Cloud）和企業資料中心（Data center）。台積公司也提供涵蓋CoWoS®、整合型扇出（Integrated Fan-Out, InFO）和TSMC-SoIC®的多種TSMC 3DFabric®先進封裝及矽堆疊技術，協助完成同質和異質晶片整合，達到客戶對高性能、高計算密度和高能源效率、低延遲以及高度整合的需求。台積公司將持續優化高效能運算平台，並強化與客戶協同合作，以幫助客戶掌握高效能運算領域的市場成長。

**智慧型手機：**針對客戶在頂級產品的應用，台積公司提供領先的N3增強型（N3 Enhanced, N3E）、N3、N4強效版（N4 Plus, N4P）、N4、N5強效版（N5 Plus, N5P）及N5等邏輯製程技術以及完備的矽智財，更進一步提升晶片效能、降低功耗及晶片尺寸。針對客戶在主流產品的應用，則提供廣泛多樣的邏輯製程技術，包括6奈米鰭式場效電晶體、7奈米鰭式場效電晶體強效版（7nm FinFET Plus, N7+）、7奈米鰭式場效電晶體、12奈米鰭式場效電晶體精簡型強效版（12nm FinFET Compact Plus, 12FFC+）、12奈米鰭式場效電晶體FinFET精簡型（12nm FinFET Compact, 12FFC）、16奈米鰭式場效電晶體精簡型強效版（16nm FinFET Compact Plus, 16FFC+）、16奈米鰭式場效電晶體精簡型（16nm FinFET Compact, 16FFC）、28奈米高效能精簡型製程技術（28nm High Performance Compact, 28HPC）、28奈米高效能精簡型強效版製程技術（28nm High Performance Compact Plus, 28HPC+）、和22奈米超低功耗（22nm Ultra-Low Power, 22ULP）等，以及完備的矽智財，滿足客戶對高性能、低功耗晶片產品的需求。此外，不論頂級與主流產品應用，台積公司也提供客戶領先業界且具高度競爭力的特殊製程技術為客戶產出配搭邏輯應用處理器的特殊製程晶片，包括射頻、射頻前端、嵌入式快閃記憶體、新興記憶體、電源管理、感測器、

顯示晶片等特殊製程技術，以及領先產業的多種TSMC 3DFabric®先進封裝技術，例如整合型扇出技術。

**物聯網：**為了滿足物聯網在多元聯網、智能和節能的三大發展趨勢，台積公司除了提供客戶堅實的邏輯技術，包括5奈米、6奈米、7奈米、12奈米、16奈米、28奈米等，亦以其邏輯技術為基礎，建構了領先、完備，且高整合度的超低功耗技術平台來實現客戶智能物聯網（Artificial Intelligence of Things, AIoT）的產品創新。

台積公司領先業界的超低功耗技術具備能源效率與高效能，包括採用FinFET架構的新一代6奈米技術—N6e™和12奈米技術—N12e™技術，能夠提供更多運算及人工智慧推論（AI inferencing）能力，並降低系統功耗。此外，基於平面電晶體架構的主流技術，例如22奈米超低漏電（Ultra-low Leakage, ULL）技術、28奈米ULP技術、40奈米ULP技術，以及55奈米ULP技術，也已被各種物聯網系統單晶片（IoT system-on-a-chip, IoT SoC）和電池供電的產品所廣泛採用以延長電池壽命。

同時，台積公司ULP技術平台也提供客戶完備的特殊製程技術，涵蓋射頻、強化版類比元件、嵌入式快閃記憶體、新興記憶體、感測器和顯示器元件、電源管理晶片等特殊製程技術，以及包括整合型扇出技術的多種TSMC 3DFabric®先進封裝技術，以支援智能物聯網廣泛且快速增長的各種產品應用，包含應用處理器（Application Processor, AP）與邊緣計算微控制器（Microcontroller, MCU）、無線連網、藍芽、基頻處理器、無線射頻辨識、顯示器元件、電源管理晶片等的需求。對於極低功耗（Extreme-low Power）產品的應用需求，台積公司更進一步擴展低操作電壓（Low Operating Voltage, Low Vdd）技術，並提供更寬操作電壓範圍的電子電路模擬模型（Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis, SPICE）及設計指南，以降低採用門檻及導入時間，協助客戶成功推出創新產品。

**車用電子：**台積公司提供完備的技術與服務，以滿足車用電子產業中的三大應用趨勢：建造更安全、更智慧和更環保的交通工具。同時，也是業界推出堅實的車用矽智財生態系統的領導公司之一，提供5奈米、7奈米與16奈米鰭式場效電晶體技術，以滿足下一代交通工具—內燃機引擎（Internal Combustion Engine, ICE）及電動車對先進駕駛輔助系統、先進座艙系統（In-Vehicle Infotainment, IVI），與針對新型電氣／電子架構的區域控制器的需求。台積公司於民國一百一十二年推出3奈米技術Auto Early（N3AE）解決方案，提供汽車製程設計套件（Process Design Kits, PDKs），支援車用客戶提早採用業界最先進的3奈米製程技術來設計車用電子應用產品。

除了先進邏輯技術平台外，台積公司亦提供廣泛而且具競爭力的車用規格（Automotive Grade）特殊製程技術，包括28奈米嵌入式快閃記憶體，28奈米、22奈米，和16奈米毫米波射頻，高靈敏度的互補式金氧半導體影像感測器（CMOS Image Sensor, CIS）／光學雷達（Light Detection and Ranging, LiDAR）感測器和電源管理晶片技術。新興的磁性隨機存取記憶體（Magnetoresistive Random Access Memory, MRAM）方面，22奈米技術已展現符合汽車Grade-1標準的能力，而16奈米技術也於民國一百一十二年通過汽車Grade-1標準的驗證。這些技術均符合台積公司基於美國車用電子協會（Automotive Electronic Council, AEC）AEC-Q100汽車等級製程規格驗證標準，或客戶對技術規格的要求。

**消費性電子：**台積公司提供客戶領先且全面的技術，以推出應用於消費性電子產品人工智慧智能元件，包括智能數位電視（Digital TV, DTV）、機上盒、具備人工智慧的智能數位相機（AI-embedded Smart Camera）及相關的無線區域網路（Wireless Local Area Network, WLAN）、電源管理晶片、時序控制器（Timing Controller, T-CON）等。台積公司領先業界的N6、N7、16FFC/12FFC、22ULP/ULL及28HPC+技術，已被全球領導的8K/4K數位電視、4K串流機上盒／過頂服務（Over-the-top, OTT）、數

位單眼相機（Digital Single-lens Reflex, DSLR）等廠商廣泛採用。針對客戶數位密集的晶片設計，台積公司將持續縮小晶片尺寸，推出更具成本效益的技術，並推出更低功耗的技術，以利採用更具成本效益的封裝。

台積公司將繼續強化其核心競爭力，適切規劃公司長短期技術及業務發展策略，並協助客戶因應電子產品週期短以及市場上激烈競爭的挑戰，以達成投資報酬率與成長目標。

#### ●短期業務發展計劃

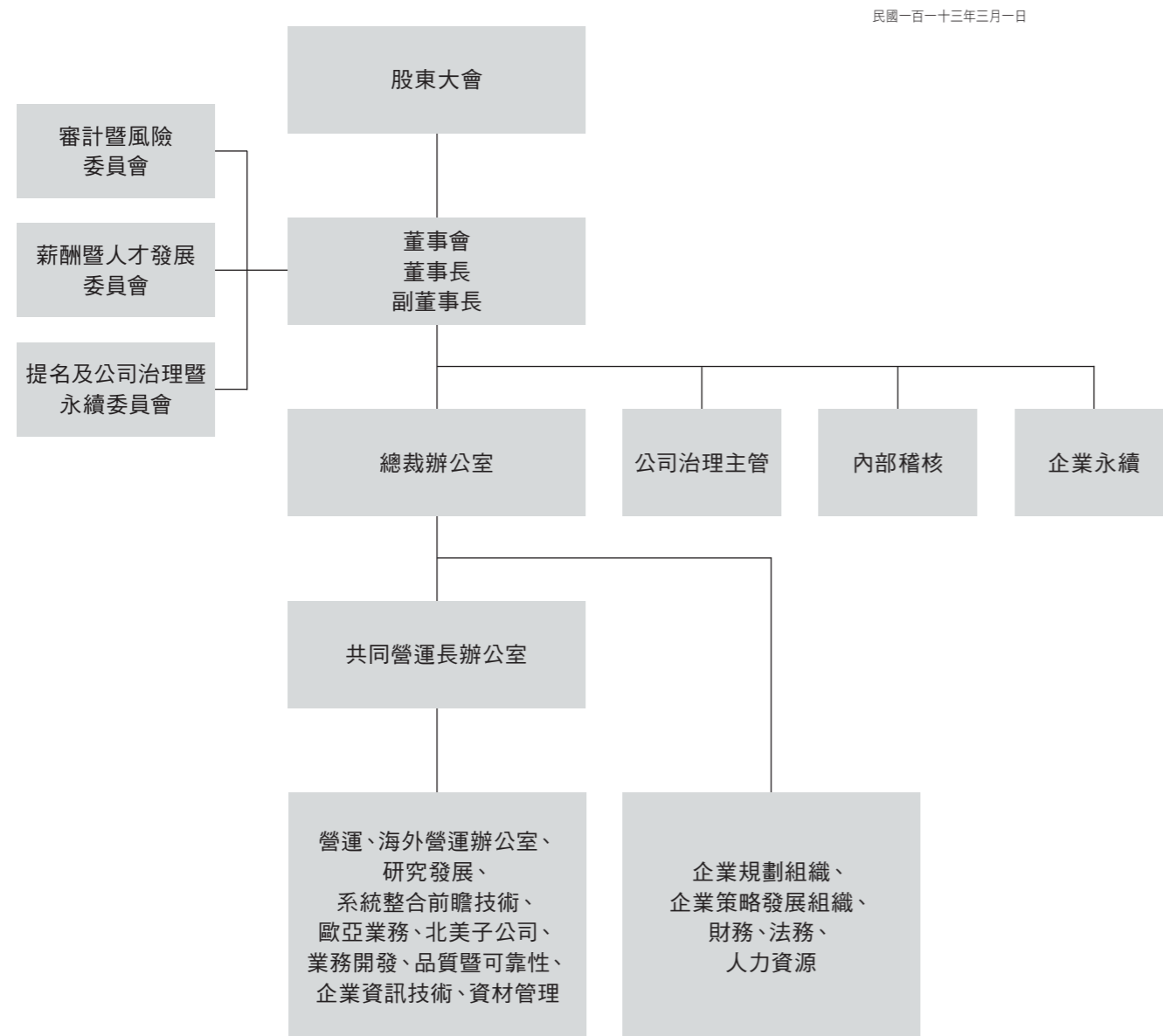
1. 持續投資擴充產能及研發，以擴大市場及維持台積公司在先進製程技術領域的市場占有率。
2. 開發新客戶及新的應用領域，以維持台積公司在主流技術製程領域的市場占有率。
3. 持續強化高效能運算、智慧型手機、物聯網、車用電子及消費性電子產品技術平台的競爭優勢，以擴展台積公司在這些產品應用的專業積體電路製造服務業務。
4. 進一步拓展台積公司在新興市場及發展中市場的業務與服務。

#### ●長期業務發展計劃

1. 持續依照可預測的節奏發展先進製程技術，提升節能運算效能。
2. 進一步發展衍生性半導體製程技術，來增加特殊製程相關應用對營業的貢獻。
3. 提供更多整合服務，涵蓋產品系統整合設計（System-Level Integration Design）、設計技術定義、設計工具發展、晶圓製造、TSMC 3DFabric®先進封裝與矽堆疊技術，以及後段封裝測試等，透過最佳化解決方案為客戶提供更高的價值。

## 2.3 公司組織

### 2.3.1 組織圖



### 2.3.2 組織功能介紹

#### 營運

- 所有生產廠區之營運管理，含台灣及海外廠區及製造技術開發；亦負責產品工程、先進封裝技術發展、生產暨服務整合

#### 海外營運辦公室

- 支持公司全球化之擴張、監督及管理 T S M C Arizona、JASM及ESMC

#### 研究發展

- 先進製程技術開發、前瞻性技術研究、設計暨技術平台發展及特殊技術開發

#### 系統整合前瞻技術

- 前瞻性系統整合技術研究

#### 歐亞業務

- 歐洲與亞洲（含中國、日本、韓國、台灣）之客戶業務、技術行銷及區域市場發展，並提供即時且全面的技術支援與含北美地區的客戶服務

#### 北美子公司

- 北美客戶業務及區域市場發展，並提供技術支援與服務

#### 業務開發

- 確認市場方向與新產品應用，進而訂定公司技術發展藍圖，並持續強化客戶關係，同時提升企業品牌形象

#### 品質暨可靠性

- 解決新製程開發時的可靠性問題，改善並管理量產時的品質，提供客戶品質問題的解決方案，並提供先進材料與故障分析等服務，以確保公司產品品質及可靠性

#### 企業資訊技術

- 整合技術及企業資訊系統，並提供資訊建構及通訊服務，致力協助運用大數據及機器學習提升營運效率與研發速度

#### 資材管理

- 採購、倉儲、進出口、運籌管理

#### 企業規劃組織

- 營運資源規劃及製造與業務需求規劃，亦負責整合企業流程，針對公司產品進行定價，且執行市場分析及預測

#### 企業策略發展組織

- 風險管理  
企業風險管理、營運持續管理與危機管理的執行

#### 企業環保安全衛生處

- 環境保護、安全與衛生管理與策略擬定

#### 企業資訊安全

- 確保資訊安全與服務品質

#### 財務暨發言人

- 公司財務、會計以及企業訊息發布；組織最高主管同時擔任公司發言人的角色

#### 法務

- 公司法務相關業務，含國內外法規遵循、商務合約、專利及其他智慧財產權管理、訴訟等

#### 人力資源

- 人力資源管理、組織發展、實體安全控管及員工服務與健康管理

#### 內部稽核

- 獨立評估內部風險控制制度，檢視此制度設計完備性及執行有效性，以確保遵循公司政策程序及政府法令規章

#### 企業永續

- 鑑別攸關公司營運與利害關係人關注的ESG議題，擬定策略、目標、行動方案並追蹤執行成效，持續創造永續價值

## 2.4 董事會成員

### 2.4.1 董事會成員簡介

截至民國一百一十三年二月二十九日止

職稱 姓名	性別 年齡	國籍或 註冊地	選(就)任 日期(註一)	任期至 (註一)	初次選任 日期(註一)	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		主要學/經歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
						股數(註二)	持股比例	股數(註二)	持股比例	股數(註二)	持股比例		
董事長 劉德音	男 66-70	美國	110/07/26	113/07/25	106/06/08	12,913,114	0.05%	12,967,192	0.05%	-	-	<b>學歷及專業資格</b> 國立台灣大學電機工程學士 美國加州大學柏克萊分校電機暨電腦資訊碩士及博士 工業技術研究院院士  <b>經歷</b> 世大積體電路製造(股)公司總經理 台積公司先進技術事業資深副總經理 台積公司營運資深副總經理 台積公司執行副總經理暨共同營運長 台積公司總經理暨共同執行長 台灣半導體產業協會理事長	無
副董事長 魏哲家	男 71-75	中華民國	110/07/26	113/07/25	106/06/08	7,179,207	0.03%	6,392,834	0.02%	700,261	0.00%	<b>學歷及專業資格</b> 國立交通大學電機工程學士及碩士 美國耶魯大學電機工程博士 國立陽明交通大學名譽博士 工業技術研究院院士  <b>經歷</b> 新加坡特許半導體公司技術資深副總經理 台積公司主流技術事業資深副總經理 台積公司業務開發資深副總經理 台積公司執行副總經理暨共同營運長 台積公司總經理暨共同執行長 台灣半導體產業協會理事長	台積公司總裁
董事 曾繁城	男 76-80	中華民國	110/07/26	113/07/25	86/05/13	34,472,675	0.13%	29,472,675	0.11%	5,132,855	0.02%	<b>學歷及專業資格</b> 國立成功大學電機工程學士 國立交通大學電機工程碩士 國立成功大學電機工程博士 國立交通大學名譽博士 國立清華大學名譽博士  <b>經歷</b> 世界先進積體電路(股)公司總經理 台積公司總經理 台積公司副總執行長 台積公司副董事長 宏碁(股)公司獨立董事、審計委員會主席及薪酬委員會委員 財團法人國家文化藝術基金會董事  <b>目前兼任非營利組織之職務</b> 財團法人台積電文教基金會董事長 財團法人雲門文化藝術基金會董事 醫療財團法人竹銘基金會董事	擔任董事長職位： - 台積電(中國)有限公司(非公開發行公司) - 創意電子(股)公司 世界先進積體電路(股)公司副董事長
董事 行政院國家發展基金管理會 (註三) 代表人： 龔明鑫	男 56-60	中華民國	110/07/26	113/07/25	75/12/10 109/07/24 (註四)	1,653,709,980 779 (註四)	6.38% 0.00%	1,653,709,980 779	6.38% 0.00%	-	-	<b>學歷及專業資格</b> 輔仁大學統計學系學士 國立台灣大學經濟學系碩士 國立中興大學經濟學研究所博士  <b>經歷</b> 淡江大學產業經濟系兼任助理教授 經濟部產業發展諮詢委員會副執行秘書 行政院科技顧問組兼任研究員 台灣經濟研究院研究員 台灣經濟研究院副院長 行政院大陸委員會諮詢委員 經濟部顧問 行政院國家金融安定基金管理委員會委員 行政院國家發展委員會副主任委員兼國家發展基金管理委員會執行秘書 經濟部政務次長 行政院政務委員  <b>目前兼任非營利組織之職務</b> 行政院政務委員兼國家發展委員會主任委員 行政院國家發展基金管理委員會召集人	台杉投資管理顧問公司董事(行政院國家發展基金管理會 代表人)(非公開發行公司)

(接次頁)

職稱 姓名	性別 年齡	國籍或 註冊地	選(就)任 日期(註一)	任期至 (註一)	初次選任 日期(註一)	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		主要學/經歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
						股數(註二)	持股比例	股數(註二)	持股比例	股數(註二)	持股比例		
獨立董事 彼得·邦菲爵士	男 76-80	英國	110/07/26	113/07/25	91/05/07	-	-	-	-	-	-	<b>學歷及專業資格</b> 英國Loughborough大學工程學士 英國Loughborough大學Honorary Doctorate of Technology 倫敦皇家工程學院院士 1996年冊封爵士勳銜 1989年獲頒CBE勳章 獲頒the Lion of Finland勳章 獲頒Institute of Management金質獎章 National Electronics Council頒發Mountbatten獎章 2019年獲頒FT ODX傑出董事獎 獲頒授名譽博士學位計11個  <b>經歷</b> 德州儀器公司半導體工程師(美國) ICL Plc董事長暨執行長(英國) 英國電信公司執行長及Executive Committee 主席 英國品質基金會副總裁 Mentor Graphics公司董事(美國) Sony公司董事(日本) L.M. Ericsson公司董事(瑞典) GlobalLogic公司董事長(美國) Hampton Group資深顧問(倫敦) Loughborough大學Chair of Council and Senior Pro-Chancellor(英國) Board Member, EastWest Institute(紐約) 恩智浦半導體公司董事長(荷蘭) Alix Partners LLP資深顧問(倫敦) The Longreach Group 公司諮詢委員會委員(香港) Board Mentor, Chairman Mentors International (CMI) 公司(倫敦)	擔任非執行董事職位： - Imagination Technologies Group公司(英國)(非公開發行公司) - Darktrace公司(英國)
獨立董事 陳國慈	女 76-80	中華民國	110/07/26	113/07/25	100/06/09	-	-	-	-	-	-	<b>學歷及專業資格</b> 英國Inns of Court School of Law 英國大律師資格 新加坡律師資格 美國加州律師資格  <b>專業經歷</b> 新加坡陳材清法律事務所律師(1969-1970) 美國紐約Sullivan & Cromwell 法律事務所律師(1971-1974) 美國舊金山Heller, Erhman, White & McAuliffe法律事務所律師(1974-1975) 聯鼎法律事務所合夥人(1975-1988) 國振法律事務所合夥人(1988-1992) 漢聲出版社副總經理(1992-1995) 財團法人國家文化藝術基金會執行長(1995-1997) 台積公司資深副總經理暨法務長(1997-2001) 「台北故事館」創辦人暨總監(2003-2015) 中華民國行政院政務顧問(2009-2016) 財團法人國家文化藝術基金會董事(2011-2016) 國家表演藝術中心董事長(2014-2017) 「迪化二〇七博物館」創辦人暨總監(2017-2022)  <b>學術經歷</b> 新加坡南洋大學講師(1970-1971) 東吳大學副教授(1981-1998) 國立清華大學客座教授(1999-2002) 國立政治大學教授(2001-2004) 東吳大學教授(2001-2008)  <b>目前兼任非營利組織之職務</b> 財團法人中華民國婦孺基金會董事 香港「Artspace K藝術空間」創辦人暨董事長(2020-)	無

(接次頁)

職稱 姓名	性別 年齡	國籍或 註冊地	選(就)任 日期(註一)	任期至 (註一)	初次選任 日期(註一)	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		主要學/經歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
						股數(註二)	持股比率	股數(註二)	持股比率	股數(註二)	持股比率		
獨立董事 麥克·史賓林特	男 71-75	美國	110/07/26	113/07/25	104/06/09	-	-	-	-	-	-	<b>學歷及專業資格</b> 美國威斯康辛大學麥迪森分校電機工程學士及碩士 美國威斯康辛大學麥迪森分校工程榮譽博士 獲頒美國半導體產業協會最高榮譽2013 Robert N. Noyce Award 美國國家工程院院士 獲頒美國公司董事協會之2020 Directorship Certified™認證  <b>經歷</b> 英特爾公司技術與製造事業群執行副總裁(美國) 英特爾公司全球業務行銷執行副總裁(美國) 應用材料公司執行長(美國) 應用材料公司董事長(美國) The NASDAQ OMX Group公司董事(美國) 矽谷領袖集團董事(Silicon Valley Leadership Group) 國際半導體產業協會(SEMI)董事 Meyer Burger Technology公司董事(瑞士) NASDAQ公司董事長(美國) Pica8公司董事(美國) 威斯康辛大學基金會董事(美國) 美台商業協會理事主席  <b>目前兼任非營利組織之職務</b> 美國商務部國家標準暨技術研究院工業諮詢委員會主席	NASDAQ公司首席獨立董事(美國) Gogoro公司(英屬開曼群島)獨立董事及薪資報酬委員會 主席 Tigo Energy公司獨立董事、薪資報酬委員會主席及提名暨 公司治理委員會委員(美國) Kioxia Holdings公司獨立董事(日本)(非公開發行公司) 擔任台移人職位: - WISC Partners創投基金(美國) - MRS商業和技術顧問公司(美國)(非公開發行公司)
獨立董事 摩西·蓋弗瑞洛夫	男 66-70	美國	110/07/26	113/07/25	108/06/05	-	-	-	-	-	-	<b>學歷及專業資格</b> Technion以色列理工學院電機工程學士 Technion以色列理工學院電腦科學碩士  <b>經歷</b> National Semiconductor公司及Digital Equipment公司歷任多項工程師及管理 工程師職務(美國) LSI Logic公司歷任多項經理人職務近10年(美國) Verisity公司執行長(美國) Cadence Design Systems公司執行副總經理及驗證處General Manager(美國) 賽靈思公司總經理暨執行長(美國) 賽靈思公司董事(美國) Wind River Systems公司執行董事長(美國)(2018-2022) San Jose Institute of Contemporary Art董事(美國)	擔任董事長職位: - SiMa Technologies公司(美國)(非公開發行公司) - Foretellix公司(以色列)(非公開發行公司) 恩智浦半導體公司獨立董事(荷蘭)
獨立董事 海英俊	男 71-75	中華民國 美國	110/07/26	113/07/25	109/06/09	-	-	-	-	-	-	<b>學歷及專業資格</b> 美國德州大學達拉斯分校國際企業管理碩士 工業技術研究院院士  <b>經歷</b> GE Capital台灣地區總經理 台達電子副董事長暨執行長(2004-2012) 台達電子經營策略管理委員會主任委員(2012-2021)  <b>目前兼任非營利組織之職務</b> 台灣雲端物聯網產業協會會策顧問 中華民國企業永續發展協會理事 財團法人台達電子文教基金會董事 財團法人中華民國企業界紀念張心治先生學術基金會監察人 蔣經國國際學術交流基金會董事及董事會財務委員會委員 台灣氣候聯盟理事長	台達電子工業(股)公司(台達電子)董事長(2012-) 台達電子永續委員會主席 台達電子所屬子公司董事: - 台達電子企業管理(上海)有限公司(非公開發行公司) - Delta Networks, Inc.(非公開發行公司) - 台達資本(股)公司(非公開發行公司) - 乾坤科技(股)公司(非公開發行公司) 台灣聚化化學品(股)公司獨立董事、審計委員會委員、 永續發展委員會委員及薪資報酬委員會召集人 中鼎工程(股)公司董事及永續與淨零委員會委員

(接次頁)



職稱 姓名	性別 年齡	國籍或 註冊地	選(就)任 日期(註一)	任期至 (註一)	初次選任 日期(註一)	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		主要學/經歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
						股數(註二)	持股比例	股數(註二)	持股比例	股數(註二)	持股比例		
獨立董事 拉斐爾·萊夫	男 71-75	美國	110/07/26	113/07/25	110/07/26	-	-	-	-	-	-	<b>學歷及專業資格</b> 委內瑞拉Carabobo大學電機工程學士 美國史丹佛大學電機工程碩士及博士 香港中文大學榮譽法學博士(2015) 清華大學(2016)、以色列Technion學院(2017)、亞利桑那州立大學(2018)及邁阿密大學(2022)榮譽博士 Tau Beta Pi, the Engineering Honor Society會員 The Electrochemical Society會員 Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 院士 美國文理科學院、美國國家工程院及中國工程院院士 美國國家發明家科學院院士 獲頒美國總統青年學者獎(1984) 美國Semiconductor Research Corporation頒發Aristotle獎(2000) 獲頒Tribeca Disruptive Innovation獎(2012) 美國Woodrow Wilson National Fellowship Foundation 頒發Frank E. Taplin, Jr. Public Intellectual獎(2015) 獲頒Great Minds in STEM年度工程師(2018) 美國國家工程院Simon Ramo Founders獎(2022) 發明或共同發明13項專利、編輯或共同編輯5本書、及指導38篇博士論文  <b>經歷</b> 委內瑞拉Simón Bolívar大學助理教授 美國史丹佛大學電機工程客座助理教授 美國麻省理工學院(MIT) 教職(1980-) MIT材料科學與工程中心IBM院士 MIT電機工程Analog Devices職涯發展教授 MIT Fariborz Maseeh新興技術教授(2004-2012) MIT微系統技術實驗室主任 MIT電機工程系副主任 MIT電機暨電腦資訊系主任 MIT教務長 Schlumberger公司董事 MIT校長(2012-2022)  <b>目前兼任非營利組織之職務</b> MIT榮譽校長(2023-) MIT Ray and Maria Stata科技中心電機工程暨電腦科學教授(2023-) 卡內基國際和平基金會Board of Trustees成員 美國外交關係協會董事 Waverley Street基金會董事(美國) Instituto Tecnológico de Monterrey · Board of Trustees成員(墨西哥)	應用材料公司Growth Technical Advisory Board共同主席(美國)

附註：

1. 董事利用他人名義持有台積公司股份：無
2. 董事與其他主管或董事具配偶或二親等以內關係：無
3. 董事長與總經理或相當職務者(最高經理人)為同一人、互為配偶或一親等親屬者：無

註一：民國年/月/日

註二：不含美國存託憑證表彰之股數。

註三：該法人股東之主要股東

法人股東名稱	法人股東之主要股東(股權比例占前十名之股東名稱)
行政院國家發展基金管理會	不適用

註四：行政院國家發展基金管理會於民國一百零九年七月二十四日指派龔明鑫先生擔任本公司代表人。

## 2.4.2 一般董事及獨立董事之酬金（註一）

單位：新台幣元

職稱 姓名	董事酬金								A、B、C及D等四項總額 及占稅後淨利之 比例(%)		兼任員工領取之相關酬金								A、B、C、D、E、F及G等 七項總額及占稅後淨利之 比例(%) (註五)		領取來自子公司 以外轉投資事業 或母公司酬金	
	報酬(A)		退職退休金(B)(註二)		董事酬勞(C)(註三)		業務執行費用(D) (註四)				薪資、獎金及特支費等(E) (註四)		退職退休金(F)(註二)		酬勞(分紅)(G)							
	本公司	財務報告內 所有公司	本公司	財務報告內 所有公司	本公司	財務報告內 所有公司	本公司	財務報告內 所有公司	本公司	財務報告內 所有公司	本公司	財務報告內 所有公司	本公司		財務報告內所有公司		本公司	財務報告內 所有公司				
														現金金額	股票金額	現金金額	股票金額					
董事長 劉德音	80,605,415	80,605,415	278,299	278,299	438,652,560	438,652,560	1,417,464	1,417,464	520,953,738 0.0621%	520,953,738 0.0621%	-	-	-	-	-	-	-	-	520,953,738 0.0621%	520,953,738 0.0621%	-	
副董事長 魏哲家	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	328,137,656	328,137,656	278,299	278,299	219,326,280	-	219,326,280	-	-	547,742,235 0.0653%	547,742,235 0.0653%	-
董事 曾繁城	-	-	-	-	10,560,000	10,560,000	1,221,743	1,221,743	11,781,743 0.0014%	11,781,743 0.0014%	-	-	-	-	-	-	-	-	11,781,743 0.0014%	11,781,743 0.0014%	19,450,666	
董事 行政院國家發展基金管理會 代表人： 龔明鑫	-	-	-	-	10,560,000	10,560,000	-	-	10,560,000 0.0013%	10,560,000 0.0013%	-	-	-	-	-	-	-	-	10,560,000 0.0013%	10,560,000 0.0013%	-	
獨立董事 彼得·邦菲爵士	-	-	-	-	16,445,264	16,445,264	-	-	16,445,264 0.0020%	16,445,264 0.0020%	-	-	-	-	-	-	-	-	16,445,264 0.0020%	16,445,264 0.0020%	-	
獨立董事 陳國慈	-	-	-	-	13,200,000	13,200,000	-	-	13,200,000 0.0016%	13,200,000 0.0016%	-	-	-	-	-	-	-	-	13,200,000 0.0016%	13,200,000 0.0016%	-	
獨立董事 麥克·史賓林特	-	-	-	-	16,445,264	16,445,264	-	-	16,445,264 0.0020%	16,445,264 0.0020%	-	-	-	-	-	-	-	-	16,445,264 0.0020%	16,445,264 0.0020%	-	
獨立董事 摩西·蓋弗瑞洛夫	-	-	-	-	16,445,264	16,445,264	-	-	16,445,264 0.0020%	16,445,264 0.0020%	-	-	-	-	-	-	-	-	16,445,264 0.0020%	16,445,264 0.0020%	-	
獨立董事 海英俊	-	-	-	-	13,200,000	13,200,000	-	-	13,200,000 0.0016%	13,200,000 0.0016%	-	-	-	-	-	-	-	-	13,200,000 0.0016%	13,200,000 0.0016%	-	
獨立董事 拉斐爾·萊夫	-	-	-	-	16,445,264	16,445,264	-	-	16,445,264 0.0020%	16,445,264 0.0020%	-	-	-	-	-	-	-	-	16,445,264 0.0020%	16,445,264 0.0020%	-	
總計	80,605,415	80,605,415	278,299	278,299	551,953,616	551,953,616	2,639,207	2,639,207	635,476,537 0.0758%	635,476,537 0.0758%	328,137,656	328,137,656	278,299	278,299	219,326,280	-	219,326,280	-	1,183,218,772 0.1411%	1,183,218,772 0.1411%	19,450,666	

\*除上表揭露外，最近年度公司董事為財務報告內所有公司提供服務（如擔任母公司／財務報告內所有公司／轉投資事業非屬員工之顧問等）領取之酬金：曾繁城博士，新台幣17,783,760元。

註一：台積公司一般董事及獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：

1. 依本公司公司章程規定，本公司董事長、副董事長及董事之報酬，依其對本公司營運參與之程度、貢獻之價值，並參酌國內外業界水準，授權由董事會議定之。
2. 公司章程中亦明訂不高於年度獲利之0.3%作為董事酬勞，且給付之對象不包括兼任經理人之董事。依本公司薪酬暨人才發展委員會組織章程之規定，董事酬勞之給付依「董事酬勞給付辦法」辦理，原則如下：(1) 董事兼任經理人者，不參與董事酬勞之分配；(2) 因所有獨立董事皆擔任審計暨風險委員會及薪酬暨人才發展委員會之委員，需承擔參與委員會會議之討論及決議之職責，故其酬勞得高於一般董事；(3) 海外獨立董事因每季來台灣開會需投入較多的時間，故其酬勞得高於國內獨立董事。

註二：此為依法提繳之退休金。

註三：董事酬勞係依預期發放金額估計入帳，若上述估列金額與實際發放金額有差異時，則依會計估計變動處理，並於完成發放年度調整入帳。

註四：此費用包含配車費用、油資補貼，但不包括給付司機之相關報酬計新台幣5,034,409元。

註五：本公司及財務報告內所有公司民國一百一十一年董事酬金（含兼任員工之相關酬金）占民國一百一十一年度稅後淨利之比例皆為0.1365%。

## 2.5 主要經理人

### 2.5.1 主要經理人資料

截至民國一百一十三年二月二十九日止

職稱 姓名	性別	國籍	就任日期 (註一)	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要學/經歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管(註三)		
				股數(註二)	持股比例	股數(註二)	持股比例	股數(註二)	持股比例			職稱	姓名	關係
總裁 魏哲家	男	中華民國	87/02/01	6,392,834	0.02%	700,261	0.00%	-	-	美國耶魯大學電機工程博士 台積公司總經理暨共同執行長 台積公司執行副總經理暨共同營運長 台積公司業務開發資深副總經理 台積公司主流技術事業資深副總經理 新加坡特許半導體公司資深副總經理	無	無	無	無
人力資源 資深副總經理 何麗梅	女	中華民國	88/06/01	4,414,753	0.02%	2,059,530	0.01%	-	-	國立台灣大學商學碩士 台積公司歐亞業務資深副總經理 台積公司財務資深副總經理暨財務長兼發言人 台積公司會計處協理 德基半導體公司副總經理暨財務長	台積公司所屬子公司董事/監察人	無	無	無
研究發展 資深副總經理 羅唯仁	男	中華民國	93/07/01	1,457,328	0.01%	-	-	-	-	美國加州大學柏克萊分校固態物理及表面化學博士 台積公司技術發展副總經理 台積公司製造技術事業副總經理 台積公司先進技術事業副總經理 台積公司營運組織二副總經理 美國英特爾公司先進技術發展協理暨CTM廠長	無	無	無	無
企業策略辦公室、海外營運辦公室 資深副總經理 台積公司亞利桑那子公司 董事長 瑞克·凱希迪	男	美國	86/11/14	-	-	-	-	-	-	美國西點軍校工程學士 台積公司北美子公司執行長 台積公司北美子公司總經理 台積公司北美子公司客戶管理副總經理	台積公司所屬子公司董事	無	無	無
營運、海外營運辦公室 資深副總經理 秦永沛(註四)	男	中華民國	76/01/01	4,932,964	0.02%	4,190,107	0.02%	-	-	國立成功大學電機工程碩士 台積公司產品發展資深副總經理 台積公司先進技術事業副總經理	台積公司所屬子公司董事	無	無	無
研究發展 資深副總經理 米玉傑(註四)	男	中華民國	83/11/14	1,016,273	0.00%	-	-	-	-	美國加州大學洛杉磯分校電機工程博士 台積公司技術發展副總經理 台積公司平台一處資深處長	無	無	無	無
資訊技術及資材暨風險管理 資深副總經理 資訊安全長 林錦坤	男	中華民國	76/01/01	12,660,501	0.05%	1,168,961	0.00%	-	-	國立彰化師範大學工業教育系學士 台積公司營運組織六吋及八吋廠暨製造技術副總經理 台積公司成熟技術事業總廠長	無	無	無	無
歐亞業務、研究發展/技術研究 資深副總經理 侯永清(註五)	男	中華民國	86/12/15	435,570	0.00%	60,802	0.00%	-	-	美國紐約雪城大學電機博士 台積公司技術發展資深副總經理 台積公司設計暨技術平台副總經理 台積公司設計暨技術平台資深處長	台積公司所屬子公司董事/總經理 台積公司轉投資公司董事	無	無	無
業務開發、海外營運辦公室 資深副總經理 張曉強(註五)	男	美國	105/11/01	115,867	0.00%	-	-	-	-	美國杜克大學電機工程博士 台積公司設計暨技術平台副總經理 美國英特爾公司技術與製造副總經理	無	無	無	無
法務 資深副總經理暨法務長 公司治理主管 方淑華(註六)	女	中華民國	84/03/20	707,793	0.00%	67,906	0.00%	384,000	0.00%	美國愛荷華大學比較法學碩士 台灣律師資格 台積公司副法務長 台灣國際專利法律事務所資深法務專員	台積公司所屬子公司董事/監察人	無	無	無
財務 資深副總經理暨財務長兼發言人 黃仁昭(註六)	男	中華民國	88/05/03	1,660,166	0.01%	-	-	-	-	美國康乃爾大學企管碩士 台積公司副財務長 台積公司財務處資深處長 英國霸菱銀行企業財務副總經理 美國大通銀行企業財務副總經理 美商信孚銀行企業財務副總經理	台積公司所屬子公司董事/監察人/ 總經理 台積公司轉投資公司董事	無	無	無
營運/晶圓廠營運一 副總經理 海外營運辦公室/台積公司亞利 桑那子公司 執行長 王英郎	男	中華民國	81/06/01	226,043	0.00%	1,135,529	0.00%	-	-	國立交通大學電子工程博士 台積公司晶圓廠營運副總經理 台積公司技術發展副總經理 台積公司十四B廠副總經理 台積公司十四B廠資深處長	台積公司所屬子公司董事	無	無	無
系統整合前瞻技術 副總經理、台積卓越科技院士 余振華	男	中華民國	83/12/28	258,496	0.00%	-	-	-	-	美國喬治亞理工學院材料工程博士 台積公司Integrated Interconnect & Packaging副總經理 台積公司Integrated Interconnect & Packaging處資深處長	無	無	無	無

(接次頁)

職稱姓名	性別	國籍	就任日期(註一)	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要學/經歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管(註三)			
				股數(註二)	持股比例	股數(註二)	持股比例	股數(註二)	持股比例			職稱	姓名	關係	
營運/先進技術暨光罩工程副總經理、台積科技院士 張宗生	男	中華民國	84/02/06	181,289	0.00%	-	-	-	-	國立清華大學電機工程博士 台積公司產品發展副總經理 台積公司十二B廠副總經理 台積公司十二B廠資深廠長	無	無	無	無	
研究發展/平台技術副總經理 吳顯揚	男	中華民國	85/12/09	493,404	0.00%	198,943	0.00%	-	-	美國威斯康辛大學麥迪森分校電機工程博士 台積公司平台研發資深處長	無	無	無	無	
研究發展/Pathfinding副總經理 曹敏	男	美國	91/07/29	371,055	0.00%	34,470	0.00%	-	-	美國史丹佛大學物理博士 台積公司Pathfinding處資深處長	無	無	無	無	
營運/晶圓廠營運二副總經理 海外營運辦公室/JASM 執行長 廖永豪	男	中華民國	77/08/03	375,532	0.00%	-	-	430,000	0.00%	國立清華大學化學工程碩士 台積公司晶圓廠營運副總經理 台積公司十五B廠副總經理 台積公司十五B廠資深廠長	台積公司所屬子公司董事 台積公司轉投資公司董事	無	無	無	無
研究發展/先進設備暨模組發展副總經理 章勳明	男	中華民國	82/09/01	356,832	0.00%	1,250	0.00%	-	-	美國麻省理工學院材料科學與工程博士 台積公司先進設備暨模組發展處資深處長	無	副處長	章勳嵐	妹妹	
研究發展/特殊技術副總經理 游秋山	男	中華民國	77/06/16	1,709,617	0.01%	219,924	0.00%	851,908	0.00%	美國伍斯理理工學院化學工程博士 台積公司歐亞業務副總經理 台積公司策略客戶專案辦公室資深處長 台積公司電子束作業處資深處長	無	無	無	無	
品質暨可靠性、營運/先進封裝技術暨服務副總經理 何軍	男	中華民國	106/05/22	33,310	0.00%	-	-	-	-	美國加州大學聖塔芭芭拉分校材料科學與工程博士 台積公司品質暨可靠性資深處長 美國英特爾公司技術暨製造群品質暨可靠性主管暨資深處長	台積公司所屬子公司董事	無	無	無	無
研究發展/平台技術副總經理 葉主輝	男	美國	105/03/21	72,532	0.00%	-	-	-	-	美國德州大學奧斯汀分校電機與計算機工程博士 台積公司平台研發資深處長 台積公司先進技術處資深處長 美國高通公司矽科技工程副總經理	無	無	無	無	
資訊技術及資材暨風險管理/企業資訊技術副總經理暨資訊長 林宏達	男	美國	110/01/04	41,137	0.00%	10,000	0.00%	-	-	美國加州大學柏克萊分校電機工程與計算機科學博士 美國Mozilla公司資訊技術副總經理 美國臉書公司企業平台架構處長	無	無	無	無	
企業規劃組織副總經理 李俊賢	男	中華民國	96/05/28	395,044	0.00%	6,000	0.00%	-	-	美國紐約市立大學柏魯克分校企管碩士 台積公司策略規劃處資深處長	無	無	無	無	
營運/廠務副總經理 莊子壽	男	中華民國	78/01/17	2,608,118	0.01%	1,993,040	0.01%	-	-	國立台灣大學土木工程博士 台積公司廠務處資深處長	無	無	無	無	
研究發展/設計暨技術平台副總經理、台積科技院士 魯立忠	男	中華民國	89/08/01	180,957	0.00%	15,000	0.00%	-	-	美國耶魯大學資訊工程博士 台積公司數位智慧財產設計方案處資深處長	無	無	無	無	
研究發展/Integrated Interconnect & Packaging副總經理 徐國晉	男	中華民國	110/11/01	90,927	0.00%	-	-	-	-	國立交通大學科技管理碩士 台灣美光公司董事長 WaferTech, LLC總經理	無	無	無	無	
營運/晶圓廠營運一副總經理 海外營運辦公室/ESMC 執行長 莊瑞萍(註七)	男	中華民國	86/12/15	180,318	0.00%	105,000	0.00%	-	-	美國史丹佛大學材料科學與工程/工程經濟系統碩士 台積公司十八A廠資深廠長 台積公司十二B廠廠長	無	無	無	無	

註一：此為加入台積公司之日期(民國年/月/日)。

註二：不含美國存託憑證表彰之股數。

註三：總經理或相當職務者(最高經理人)與董事長為同一人、互為配偶或一親等親屬者：無。

註四：秦永沛先生及米玉保博士於民國一百一十三年三月一日被任命為執行副總經理暨共同營運長。

註五：侯永清博士及張曉強博士於民國一百一十三年三月一日被任命為資深副總經理暨副共同營運長。

註六：方淑華女士及黃仁昭先生於民國一百一十三年二月六日獲擢升為資深副總經理。

註七：莊瑞萍先生於民國一百一十二年五月九日獲擢升為副總經理。

## 2.5.2 總裁及副總經理之酬金（註一）

單位：新台幣元

職稱	姓名	薪資 (A)		退職退休金 (B) (註五)		獎金及特支費等 (C) (註六)		酬勞 (分紅) 金額 (D)				A、B、C及D等四項總額及 占稅後淨利之比例 (%) (註七)		領取來自子公司以外轉投資 事業或母公司酬金
		本公司	財務報告內 所有公司	本公司	財務報告內 所有公司	本公司	財務報告內 所有公司	本公司		財務報告內所有公司		本公司	財務報告內 所有公司	
								現金金額	股票金額	現金金額	股票金額			
總裁	魏哲家	14,962,410	14,962,410	278,299	278,299	313,175,246	313,175,246	219,326,280	-	219,326,280	-	547,742,235 0.0653%	547,742,235 0.0653%	-
資深副總經理暨財務長兼發言人	黃仁昭	5,995,500	5,995,500	111,517	111,517	57,211,091	57,211,091	40,179,742	-	40,179,742	-	103,497,850 0.0123%	103,497,850 0.0123%	-
資深副總經理	何麗梅	136,548,315	162,258,591	2,539,793	3,202,056	1,388,757,585	1,584,248,205	980,476,267	-	980,476,267	-	2,508,321,960 0.2991%	2,730,185,119 0.3256%	-
資深副總經理	羅唯仁													
資深副總經理／台積公司亞利桑那 子公司董事長	瑞克·凱希迪													
資深副總經理	秦永沛 (註二)													
資深副總經理	米玉傑 (註二)													
資深副總經理／資訊安全長	林錦坤													
資深副總經理	侯永清 (註三)													
資深副總經理	張曉強 (註三)													
資深副總經理暨法務長／公司治理主管	方淑華													
副總經理	王英郎													
副總經理、台積卓越科技院士	余振華													
副總經理、台積科技院士	張宗生													
副總經理	吳顯揚													
副總經理	曹敏													
副總經理	廖永豪													
副總經理	章勳明													
副總經理	游秋山													
副總經理	何軍													
副總經理	葉主輝													
副總經理暨資訊長	林宏達													
副總經理	李俊賢													
副總經理	莊子壽													
副總經理、台積科技院士	魯立忠													
副總經理	徐國晉													
副總經理	莊瑞萍 (註四)													
總計		157,506,225	183,216,501	2,929,609	3,591,872	1,759,143,922	1,954,634,542	1,239,982,289	-	1,239,982,289	-	3,159,562,045 0.3768%	3,381,425,204 0.4033%	-

註一：台積公司給付經理人酬金之政策、標準與組合、程序及與經營績效及未來風險之關聯性：本公司經理人獲派之酬金金額，乃依其職務、貢獻、該年度公司經營績效及考量公司未來風險，經薪酬暨人才發展委員會審議並送交董事會決議。

註二：秦永沛先生及米玉傑博士於民國一百一十三年三月一日被任命為執行副總經理暨共同營運長。

註三：侯永清博士及張曉強博士於民國一百一十三年三月一日被任命為資深副總經理暨副共同營運長。

註四：莊瑞萍先生於民國一百一十二年五月九日獲擢升為副總經理。申報金額未含其被擢升前的薪酬。

註五：此為依法提繳之退休金。

註六：此費用包含公司民國一百一十二年五月、八月、十一月及民國一百一十三年二月發放之業績獎金及配車費用、油資補貼。

註七：本公司民國一百一十一年經理人之酬金，占民國一百一十一年度稅後淨利之比例為0.3700%，財務報告內所有公司民國一百一十一年經理人之酬金占民國一百一十一年度稅後淨利之比例為0.3846%。

### 本公司給付總裁及副總經理酬金之政策、標準與組合、訂定程序，與績效評估之連結及與未來風險之關聯性

#### ● 酬金之政策、標準與組合

本公司給付總裁及經理人之酬金政策，係參酌其經歷、專業能力、管理職能及所擔任之職位等綜合面向，亦與財務性及非財務性等績效目標連結，以反映職責及工作績效。酬金包含薪資、按季發放之業績獎金、特支費，以及公司根據年度獲利狀況所發放之員工酬勞（分紅），並自民國一百一十一年起新增限制員工權利新股，以連結股東利益及ESG成果。

本公司變動酬金占總體酬金之比例高於固定酬金占總體酬金之比例，並著重長期激勵性獎酬，使總裁及經理人之酬金與公司之長期經營績效、股東利益及ESG成果更加連結。前述酬金將定期由薪酬暨人才發展委員會審核，並經董事會決議核准。

#### ● 酬金之訂定程序

每季業績獎金及年度員工酬勞（分紅）是為回饋同仁，獎勵其貢獻，並激勵同仁繼續努力，讓員工利益連結股東利益。

依本公司章程規定，年度如有獲利，公司分派盈餘前，應提撥年度獲利不低於百分之一為員工酬勞。業績獎金及員工酬勞（分紅）之發放次數、發放日期及發放要件，依公司獎金辦法辦理；實際分派比率、金額與分配方式，係依據公司營運成果並參考國內業界發放水平，由薪酬暨人才發展委員會向董事會提議，業績獎金於每季發放，員工酬勞於董事會核准並於股東會報告後發放。

本公司另訂定限制員工權利新股發行辦法，使總裁及經理人之獎酬與股東利益及ESG成果連結，總裁及經理人之限制員工權利新股獲配股數乃參酌公司營運成果、個人職級、工作績效及其它適當參考因素，由董事長與總裁提出，經薪酬暨人才發展委員會同意並提報董事會核准。

● 酬金與績效評估之連結

本公司總裁及經理人酬金依據公司獎金辦法辦理，辦法涵蓋公司營運目標及個人年度目標之達成。公司目標包含財務及非財務指標，個人年度目標含營運目標及ESG指標（著重於綠色製造、打造多元包容職場、建立責任供應鏈、培育人才、關懷弱勢），每位經理人獲派的金額，依職務、貢獻、績效表現而定。經理人報酬包含限制員工權利新股，既得期間為三年（限制員工權利新股相關資訊，請參閱本年報「4.6.1 限制員工權利新股辦理情形」，第86-91頁），以公司營運成果指標（公司股東總報酬率（TSR）指標相對標準普爾500 IT指數TSR）達成情形以及公司ESG成果為調整項。透過這兩個明確的量化指標可以強化管理階層長期並持續創造股東價值同時提高ESG目標達成績效，此與公司經營績效呈高度關聯性。

● 酬金與與未來風險之關聯性

本公司總裁及經理人之酬金除參考相關同業水準及公司經營績效給付外，其發放標準、結構與制度亦將隨時視實際營運狀況及相關法令變動適時檢討調整之，且不以引導經理人為追求酬金而從事逾越公司風險之行為，以確保公司永續經營與風險控管之平衡。

● 薪酬索回政策

台積公司於民國一百一十二年訂定薪酬索回政策。（揭露於台積公司官網首頁/投資人關係/公司治理/重要公司內規/薪酬索回政策）

給付總裁及副總經理酬金級距

	民國112年度	
	本公司	本公司及所有轉投資事業
0 元~ 1,000,000元 (不含)	瑞克·凱希迪	無
1,000,000元 (含) ~ 2,000,000元 (不含)	無	無
2,000,000元 (含) ~ 3,500,000元 (不含)	無	無
3,500,000元 (含) ~ 5,000,000元 (不含)	無	無
5,000,000元 (含) ~ 10,000,000元 (不含)	無	無
10,000,000元 (含) ~ 15,000,000元 (不含)	無	無
15,000,000元 (含) ~ 30,000,000元 (不含)	無	無
30,000,000元 (含) ~ 50,000,000元 (不含)	莊瑞萍	莊瑞萍
50,000,000元 (含) ~ 100,000,000元 (不含)	方淑華、王英郎、張宗生、吳顯揚、曹敏、廖永豪、章勳明、游秋山、何軍、葉主輝、林宏達、李俊賢、莊子壽、魯立忠、徐國晉	方淑華、王英郎、張宗生、吳顯揚、曹敏、廖永豪、章勳明、游秋山、何軍、葉主輝、林宏達、李俊賢、莊子壽、魯立忠、徐國晉
100,000,000元以上	魏哲家、黃仁昭、何麗梅、羅唯仁、秦永沛、米玉傑、林錦坤、侯永清、張曉強、余振華	魏哲家、黃仁昭、何麗梅、羅唯仁、瑞克·凱希迪、秦永沛、米玉傑、林錦坤、侯永清、張曉強、余振華
總計	27	27

2.5.3 分派員工酬勞（分紅）之經理人姓名及分派情形

單位：新台幣元

職稱	姓名	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後淨利之比例 (%)
總裁	魏哲家	-	219,326,280	219,326,280	0.0262%
資深副總經理暨財務長兼發言人	黃仁昭	-	40,179,742	40,179,742	0.0048%
資深副總經理	何麗梅	-	980,476,267	980,476,267	0.1169%
資深副總經理	羅唯仁				
資深副總經理／台積公司亞利桑那子公司董事長	瑞克·凱希迪				
資深副總經理	秦永沛（註一）				
資深副總經理	米玉傑（註一）				
資深副總經理／資訊安全長	林錦坤				
資深副總經理	侯永清（註三）				
資深副總經理	張曉強（註三）				
資深副總經理暨法務長／公司治理主管	方淑華				
副總經理	王英郎				
副總經理、台積卓越科技院士	余振華				
副總經理、台積科技院士	張宗生				
副總經理	吳顯揚				
副總經理	曹敏				
副總經理	廖永豪				
副總經理	章勳明				
副總經理	游秋山				
副總經理	何軍				
副總經理	葉主輝				
副總經理暨資訊長	林宏達				
副總經理	李俊賢				
副總經理	莊子壽				
副總經理、台積科技院士	魯立忠				
副總經理	徐國晉				
副總經理	莊瑞萍（註三）				
總計		-	1,239,982,289	1,239,982,289	0.1479%

註一：秦永沛先生及米玉傑博士於民國一百一十三年三月一日被任命為執行副總經理暨共同營運長。  
 註二：侯永清博士及張曉強博士於民國一百一十三年三月一日被任命為資深副總經理暨副共同營運長。  
 註三：莊瑞萍先生於民國一百一十二年五月九日獲擢升為副總經理。申報金額未含其被擢升前的薪酬。